

未来は、
あなたの技術から

参加者
募集中

半導体関連産業 参入促進セミナー

北海道では、Rapidus株式会社の立地を契機として、半導体の製造・研究・人材育成等が一体となった複合拠点の実現を目指しています。本セミナーでは、半導体関連産業への参入を検討されている皆様を対象に、参入事例の紹介と交流会を実施します。

開催日時 **2026年10月15日(木)**

開場 13:30 / 開演 14:00～17:05

開催会場 **北海道新聞社1階 DO-BOX EAST**

〒060-8711 北海道札幌市中央区大通東4丁目1番地

対象 **半導体関連産業への参入を検討している道内企業**

定員 **100名** **参加無料** 申込みは先着順となります。

※オンラインでの配信も実施します。(事前申込みが必要となります)

お申込方法 右記の2次元コードより、「現地参加」または「オンライン参加」のどちらかご希望の参加方法を選択の上、お申し込みください。

<https://survey.hokkaido-np.co.jp/zs/4yD6JQ>



セミナー講師

株式会社産業タイムズ社 もたい 秀樹 氏
事業開発部 部長

株式会社ミラプロ 中川 智郁 氏
専務取締役

TOWA株式会社 大西 洋平 氏
INNOMS推進室 室長

アオイ電子株式会社 澤本 修一 氏
執行役員 営業企画本部 本部長

交流会 (名刺交換会) セミナー終了後 (希望者のみ)

■ お問い合わせ

令和8年度半導体関連産業に係る複合拠点化事業
(半導体関連産業参入促進事業) 受託者

株式会社北海道新聞社 営業局内 / 担当者 大和

電話: 011-210-5902 (10:00～17:00 ※土日祝除く)

半導体関連産業参入促進セミナー

プログラム

14:00～14:05	開 会 主催者あいさつ	北海道経済部	AI・DX推進局次世代半導体戦略室 室長	浦田 哲哉
14:05～14:35	講演① 高成長に沸く半導体市場の最新動向と北海道にもたらす未来	株式会社産業タイムズ社	事業開発部 部長	もたい 甕 秀樹 氏
14:35～15:05	講演② 株式会社ミラプロの半導体市場への参入の歴史と今後の展開について	株式会社ミラプロ	専務取締役	中川 智郁 氏
15:10～15:40	講演③ 半導体パッケージングを支えるモールドイング技術	TOWA株式会社	INNOMS推進室 室長	大西 洋平 氏
15:40～16:10	講演④ 半導体後工程におけるサプライチェーン	アオイ電子株式会社	執行役員 営業企画本部 本部長	澤本 修一 氏
16:10～16:20	関係機関からのお知らせ	公益財団法人北海道中小企業総合支援センター		
16:25～16:35	質疑応答 ※現地のみ			
16:35～17:05	交流会(名刺交換会) ※現地のみ			

講師紹介



株式会社産業タイムズ社

事業開発部 部長

もたい

甕

秀樹 氏

半導体メーカー、半導体業界誌記者を経て、2002年に株式会社産業タイムズ社に入社。「半導体産業新聞(現:電子デバイス産業新聞)」副編集長(2008年～2010年)、「週刊ナノテク」編集長(2003年～2007年)、「環境エネルギー産業情報」編集長(2010年～2014年)を歴任し、2014年3月より現部署に。「これが半導体の全貌だ」(共著、かんき出版)などを執筆。

<会社紹介>

株式会社産業タイムズ社は、半導体や電子デバイスの業界紙「電子デバイス産業新聞」を軸に、産業界の「設備投資」を柱とした情報を提供する総合的なメディア企業です。

<講演内容>

半導体産業が日本でどのように根付いてきたかについて、国内の先進地域の産業集積事例を交えながらご紹介します。

講演①



株式会社ミラプロ

専務取締役

中川 智郁 氏

北海道大学工学部合成化学工学科卒業。2014年、株式会社ミラプロに入社し、製造本部長を務める。その後、執行役員、取締役、常務取締役を歴任し、2022年6月より専務取締役に就任。製造現場から経営まで幅広い知見と経験を活かし、ミラプロの事業成長を牽引している。

<会社紹介>

真空技術をコアに、確かな技術力と知識を培ってきたミラプロ。その技術を多角的に応用し、半導体をはじめ、医療・科学・AIなど幅広い分野で新たな価値の創出に挑戦しています。

<講演内容>

株式会社ミラプロが半導体市場に展開する真空部品の紹介と最先端半導体市場へ納品される製造装置向け要素技術開発および各国に展開するサテライト設計の紹介など。

【関連する業種の一例】

- ・金属製品製造: 金属製品、めっき等
- ・機械器具製造: 生産用機械器具、計量器、測定器、光学機械・レンズ等精密機械器具等



TOWA株式会社

INNOMS推進室 室長

大西 洋平 氏

2000年に京都工芸繊維大学を卒業後、TOWA株式会社へ入社。以来、半導体パッケージのモールドイング技術開発に従事。現在はINNOMS推進室長として、独自のコンプレッション技術を進化させた次世代モールドイング装置「INNOMS」の開発・事業推進を担当。半導体後工程の新たなスタンダード創出と持続可能な量産ソリューションの実現に取り組んでいる。

<会社紹介>

半導体後工程で使用するモールドイング装置や精密金型の開発・製造・販売を手掛ける京都のメーカー。先端半導体のパッケージ製造を支える技術を提供しています。

<講演内容>

TOWA株式会社の概要に加え、半導体後工程におけるモールドイング技術や独自のコンプレッション技術、先端パッケージ分野への取り組みについて、市場動向も交えながら紹介します。

【関連する業種の一例】

- ・幅広い業種に関連しています。

講演③



アオイ電子株式会社

執行役員 営業企画本部 本部長

澤本 修一 氏

1991年にミツミ電機に入社、半導体後工程のエンジニアとして、新製品開発、海外新工場立上げ等に従事。その後、海外OSATのSTATSChipPACにてテクニカルプログラムマネージャーとして最先端後工程製品を国内お客様と開発。2008年アオイ電子に入社し営業部門を担当、現在は営業企画部門で新規開拓、マーケティングを中心に活動。

<会社紹介>

国内最大の半導体OSATとしてレガシーから最先端Chiplet製品までを展開。高品質なものづくりで国内外の産業を支える企業です。

<講演内容>

半導体分野参入検討企業様に、アオイ電子が手掛ける半導体後工程の説明を通して、後工程に必要なプロセス・材料等についてご紹介いたします。また後工程業界団体の日本OSAT連合概要についてもご案内いたします。

【関連する業種の一例】

- ・金属製品製造: 金属製品、めっき等
- ・機械器具製造: 生産用機械器具、計量器、測定器、光学機械・レンズ等精密機械器具等
- ・電気機械器具製造: 電子部品・デバイス・電子回路製造、電気機械器具、情報通信機械器具等
- ・化学工業: 無機・有機化学工業、石油製品、医薬品、ゴム製品、プラスチック製品、界面活性剤、洗浄剤等